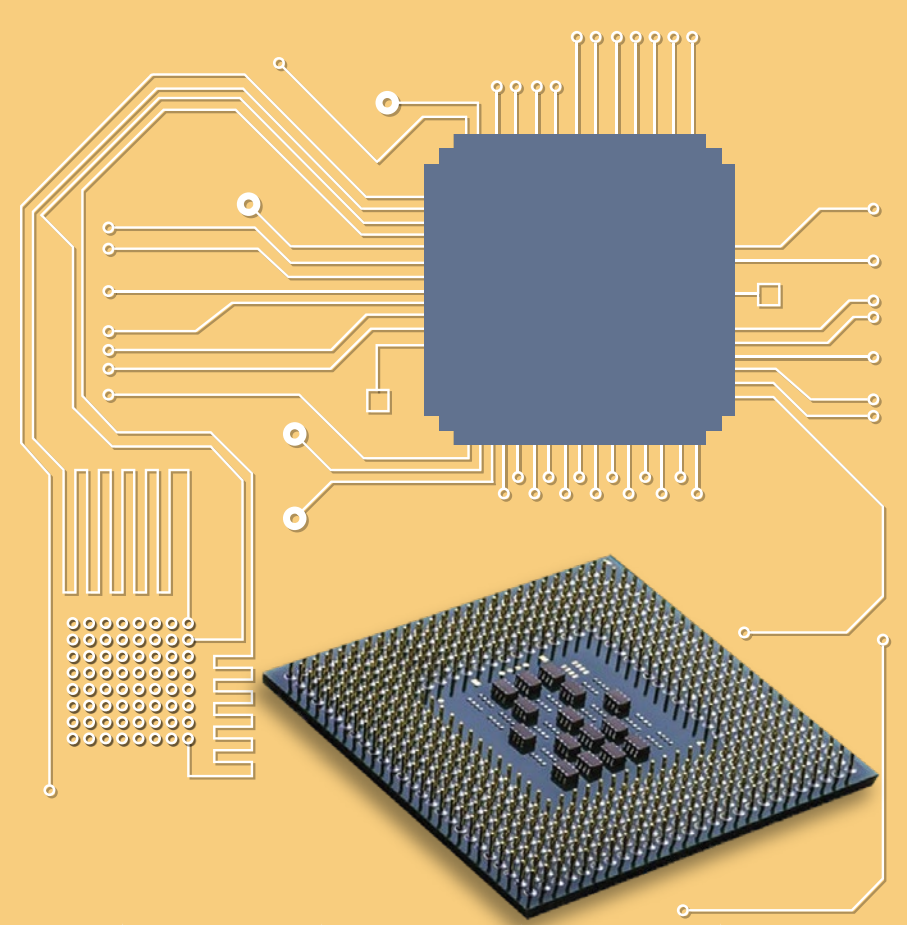


半導体産業

の競争力及び供給網を強化すべく、

BOIは前工程の恩典を拡充。



第1グループ 半導体素子の製造

半導体の前工程：
ウェハーの製造

例：

- ★ 電子設計
- ★ シリコンウェハー
- ★ ウェハファブ

法人所得税
免除

10年間

高度技術・イノベーションを使用する
事業と見なされる。

半導体素子および/または
半導体素子部品の製造

例：

- ★ ウェハソーティング
- ★ ダイバンプ
- ★ アセンブリ
- ★ ICテスト

法人所得税
免除

8年間

機械への
投資額が
15億バーツ
以上



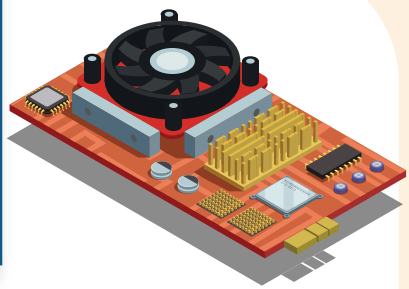
法人所得税
免除

5年間

機械への
投資額が
15億バーツ
未満



第3グループ 電子回路基板の製造



プリント回路基板アセンブリ
(PCBA)の製造

例：

- ★ Box build
- ★ Product Test
- ★ Pack/Ship

法人所得税
免除

5年間

機械への
投資額が
5億バーツ
以上



法人所得税
免除

3年間

機械への
投資額が
5億バーツ
未満



第2グループ プリント回路基板の製造

多層またはフレキシブル
プリント回路基板(PCB)の製造

例：

- ★ PCBファブ
- ★ ファブラボ

- ★ 表面実装
- ★ スルーホール
- ★ PCBAテスト
- ★ めっき

法人所得税
免除

8年間

機械への
投資額が
15億バーツ
以上



法人所得税
免除

5年間

機械への
投資額が
15億バーツ
未満

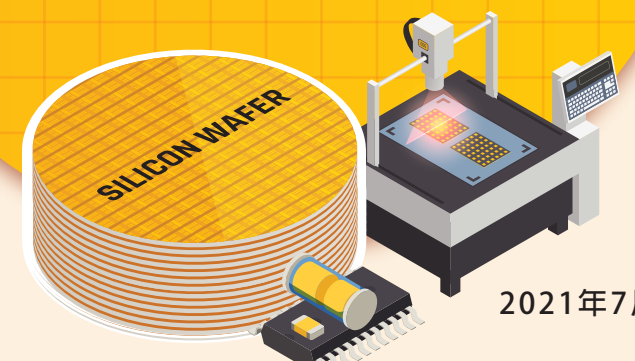
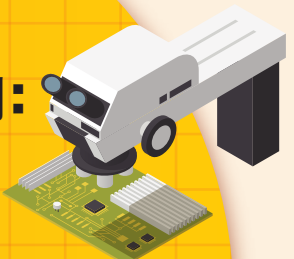


追加恩典

競争力向上への
追加の投資がある場合、例：

★ 研究開発 ★

最長5年間の法人所得税免除の
追加恩典が付与される。



2021年7月現在